证券代码：603005　　证券简称：晶方科技　　公告编号：临2026-035

苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于 2026 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月18日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心（网址：https://www.ir-online.cn/）以网络文字互动的方式召开了2026年第三季度业绩说明会，针对公司2026年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年11月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2026-034），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2026年11月18日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心（网址：https://www.ir-online.cn/）以网络文字互动的方式召开了2026年第三季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2026年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题一：1、公司前三季度研发费用同比增长24%，Q3环比增幅近50%。请问

增量研发投入主要投向哪些具体技术方向或产品？ 2、公司之前介绍产线稼动率稳步提升，Q3营收及盈利也环比改善。结合当前订单及客户指引来看，该趋势能否在Q4和2027年保持，并进而扭转盈利同比下降的压力？ 3、如何展望2027年各业务线的需求景气度？封测和光学器件业务需求是否出现分化？ 4、请问马来西亚产线的投产进度如何，如何评估新产线对明年毛利率及整体盈利的影响？

回答：您好，感谢您的关注。（1）2026年前三季度公司研发费用1.29亿元，同比增长24.45%；其中Q3单季0.57亿元、环比增长约49%。研发投入一方面聚焦车规CIS市场需求，持续推进晶圆级TSV封装工艺的迭代创新，同时拓展开发OBGA封装工艺，形成多样化的技术服务能力；另一方面聚焦BONDING、TSV、RDL、WAFER(CHIP) ON WAFER等核心工艺进行创新开发，满足端侧智能感知微型化、高集成、低功耗、感存算多模态异构集成的封装工艺需求。

（2）Q3公司营业收入3.81亿元、环比增长11.14%，毛利率48.32%、环比提升3.68个百分点，归母净利润0.71亿元、环比增长5.19%，公司收入已连续两个季度环比改善，产线稼动率稳步提升，与行业库存逐步消化、公司运营调整与效率提升策略初显成效有关。随着公司市场及公司运营策略的持续推进，公司预计2026年Q4及2027年运营态势有望持续保持乐观趋势。

（3）展望2027年，智能汽车、机器人、眼镜等端侧应用市场的持续发展，驱动CIS市场需求长期趋势向好，并对公司封测与光学业务形成积极推动。

（4）马来西亚生产基地建设正在稳步推进之中，正处于设备购置、安装调试与产线打样验证阶段，形成规模产能运营后有利于公司提升公司海外客户与市场份额，巩固公司产业链地位，当然在初始运营阶段，效率与盈利能力也会有一个爬坡提升的过程。 谢谢！

问题二：公司在上证互动回复说，公司不断拓展MEMS、Filter等非CIS应用领域，并已实现商业化量产，相关领域有望成为公司未来业务发展新的增长驱动。请问王蔚董事长，公司牵头研发的国家重点项目《MEMS传感器芯片先进封装测试平台》，已经助力公司在相关领域形成领先优势吗，对公司进入更多高端车规、工业级MEMS大客户，进入物理AI和端侧应用，以及射频MEMS、智能感知等高附加值品类业务形成实质支撑吗？

回答：随着物理AI与端侧智能的发展驱动，感知正从单一信号采集，逐步向

感、存、算一体化方向延伸，从单一视觉感知，走向视觉、触觉、姿态、空间等多模态融合，从而在本地完成边缘/端侧数据预处理。这一趋势将对封装工艺提出创新需求，以满足其微型化、高集成、低功耗、异构堆叠的产品需求。公司专注于智能感知芯片的封装测试服务，在影像传感领域建立了显著的行业领先地位，公司长期深耕拥有的BONDING、TSV、RDL、WAFER(CHIP) ON WAFER等核心工艺，也有望成为智能感知创新发展的封装工艺支撑。公司将积极努力，依托公司在智能感知领域的既有产业地位、技术能力，把握MEMS、智能感知等相关端侧应用的市场机遇。

问题三：公司目前是半导体板块里少有的高毛利高PS零增长的组合。请问王蔚董事长，荷兰子公司分拆上市后将对公司发展和估值带来哪些影响？之前市场默认公司是“封装光学一体化协同”，愿意给整体一个高PS；分拆后市场主流定价可能变成分部估值，欧洲资金最高能给予多少成长溢价？此前公司通过海外布局，业务已由单一光学元件逐步向光学组件、光机电模块及系统延伸，产品结构向更高附加值方向升级，分拆上市后会加快这一趋势吗？

回答：您好，公司正在积极推进荷兰子公司的分拆上市工作，相关具体信息请您关注后续正式公告。物理人工智能让端侧应用能够在本地感知视觉、听觉、空间等信息并解读周边环境，提供实时智能能力、更强的隐私保护以及流畅的用户体验，它的发展除了需要端侧处理器，也需要传感器、光学器件等硬件支持。公司一方面专注于传感芯片的封装测试服务，另一方面拓展布局光学器件与系统集成的设计、研发与制造能力，驱动公司业务从单一封装向光机电系统集成拓展延伸。荷兰子公司的分拆上市，将积极推动公司光学业务与技术工艺的发展，从而提升公司的整体业务能力。

问题四：贵公司今年研发经费增加在具体哪一方面？是主营业务CIS 芯片，还是其他方面。马来西亚工厂建设完成后，产量相较于现在增加多少？

回答：您好，公司研发主要聚焦BONDING、TSV、RDL、WAFER(CHIP) ON WAFER等核心工艺进行创新开发。马来西亚生产基地建设正在稳步推进之中，正处于设备购置、安装调试与产线打样验证阶段，谢谢您的关注。

问题五：公司此前披露，马来西亚生产基地预计2026年底进入打样、试生产阶段。目前距离年底已经不远，请问目前生产设备的采购、进场、安装调试分别

完成了多少？是否已经具备首批产品打样条件？预计何时正式启动试生产？2027年能否形成实际营业收入？

回答：您好，马来西亚生产基地正处于设备购置、安装调试与产线打样验证阶段，争取2026年底能实现小规模量产，并在2027年产生营业收入，谢谢您的关注。

问题六：公司收购Anteryon后，其业务正在向高精度光学系统、光子器件等方向拓展。请问目前Anteryon在微透镜阵列（MLA）、光通信以及CPO/NPO相关光学器件方面的研发和客户验证进展如何？是否已经从研发打样阶段进入小批量交付阶段？相关业务预计何时能够形成实质性收入？

回答：您好，公司光学业务涵盖精密光学设计、晶圆级光学制造、精密玻璃加工和光学系统模块集成，服务于半导体设备、工业自动化、车用智能投射、激光雷达、AR/VR检测等应用领域，其中微透镜阵列（MLA）已处于量产阶段，其他领域正在积极开发拓展进程中。

问题七：公司此前披露，针对光电共封装（CPO）需求的微透镜阵列产品已完成多轮设计优化，并配合核心客户持续验证与交付。请问目前客户验证是否取得新的进展？产品是否已经进入小批量交付阶段？公司在该领域主要提供微透镜阵列、光学组件还是更完整的光学封装解决方案？

回答：关于公司光学业务的拓展情况请见前述回复，谢谢！

问题八：关于Anteryon分拆至荷兰阿姆斯特丹交易所上市事宜，公司此前在半年度业绩说明会上表示争取2026年内完成相关工作。目前距离年底已不远，想进一步了解：1、Anteryon目前是否已经正式向荷兰AFM提交招股说明书，或向Euronext提交上市申请？目前具体处于哪个阶段？2、荷兰当地IPO法律顾问、Listing Agent以及国际主承销商是否已经正式聘请？如果已经确定，能否适当披露相关机构名称？3、考虑到目前剩余时间较短，公司是否仍有把握在2026年内完成正式挂牌？如果存在延期可能，预计是否顺延至2027年？另外，近期荷兰安世半导体事件引发了市场对中资企业在欧洲资本市场上市及监管环境的关注，请问公司是否评估过相关事件对Anteryon分拆上市的潜在影响？希望公司能够尽可能披露目前的实际进展，而不仅仅是表示项目正在有序推进。谢谢！

回答：您好，感谢您的关注，Anteryon分拆上市各项工作均在有序推进，本

次分拆尚需取得阿姆斯特丹交易所批准，公司正在全力推进相关事宜，相关工作进展涉及商业与信息披露规则要求，具体情况请您届时关注公司正式公告为准，谢谢您的谅解。您所关注的监管环境变化情况，目前也没有对Anteyon分拆上市的有序推进产生影响。

问题九：你好，请问马来西亚项目什么时候能投产？

回答：您好，公司正在推进海外生产基地建设，已完成土地、厂房购买，无尘室与厂务系统等基础设施建设，正处于设备购置、安装调试与产线打样验证阶段，谢谢您的关注！

问题十：按公司激励考核指标设定，以2025年营业收入为基数，明后年增长率不低于3%和6%。市场普遍感觉太低。请问王蔚董事长，这个增速设定只是底线，不是指引，对不对？因为之前基于对公司的信任，对王蔚董事长的信任，市场一直预期公司CIS将进入放量期，即使不算马来基地年底投产、荷兰子公司分拆上市快速发展、推进CPO光电共封装赛道等带来的新的也许更大的营收增速，也应该远高于3%和/6%的底线，这个推论还对不对？

回答：您好，本次股权激励的背景是2024年2月，公司响应“提质增效重回报”号召，通过集中竞价方式回购公司股份74.77万股，回购股份的用途为用于股权激励或员工持股计划。鉴于回购股份规模有限，本次股权激励主要聚焦光学器件业务的发展，在考核指标上也以光学器件业务收入作为核心考核指标，具体为以2025年光学器件业务收入为基数，设定2026年、2027年增长率分别不低于15%、25%。该指标设置显著高于过去三年公司光学器件业务年均复合增速，兼具了考核的强约束性与较高的增长预期。在设置光学器件业务核心考核指标的同时，结合行业市场、下游大客户经营情况，公司也将整体营业收入作为辅助考核指标，具体指标目标为以公司2025年营业收入为基数，公司2026年营业收入增长率不低于3%，2027年营业收入增长率不低于6%。考核维度上需要公司光学器件业务收入、整体营业收入两项指标需同时满足，才能达到激励的考核条件，有效提升了股权激励指标的全面性、严谨性。

问题十一：晶方在上证互动回复说，公司不断拓展MEMS、Filter等非CIS应用领域，并已实现商业化量产，相关领域有望成为公司未来业务发展新的增长驱动。请问王蔚董事长，公司牵头研发的国家重点项目《MEMS传感器芯片先进封

装测试平台》，已经助力公司在相关领域形成领先优势吗，对公司进入更多高端车规、工业级MEMS大客户，进入物理AI和端侧应用，以及射频MEMS、智能感知等高附加值品类业务形成实质支撑吗？

回答：请见前述回复，谢谢您的关注！

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见价值在线路演中心（网址：https://www.ir-online.cn/）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日